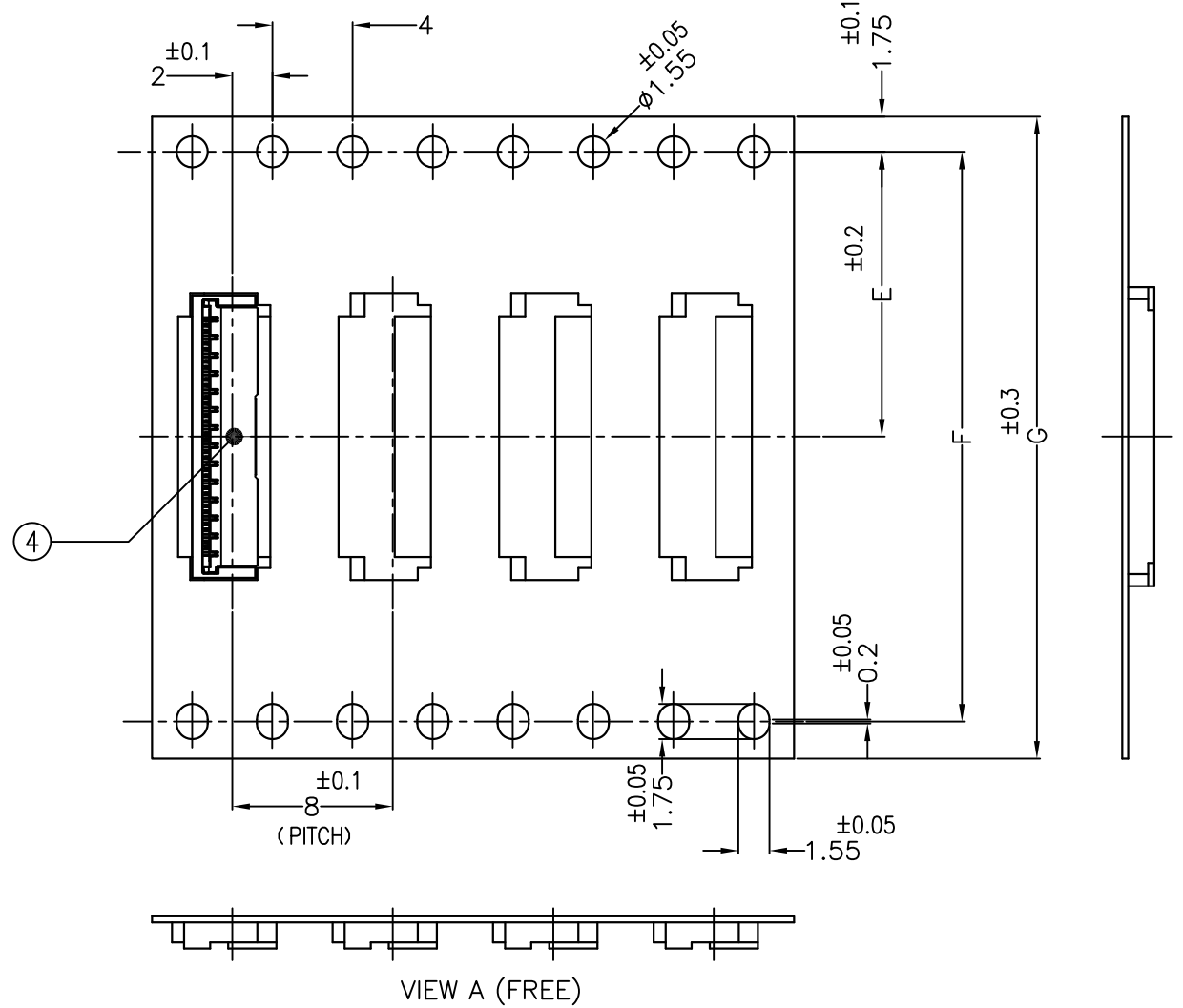
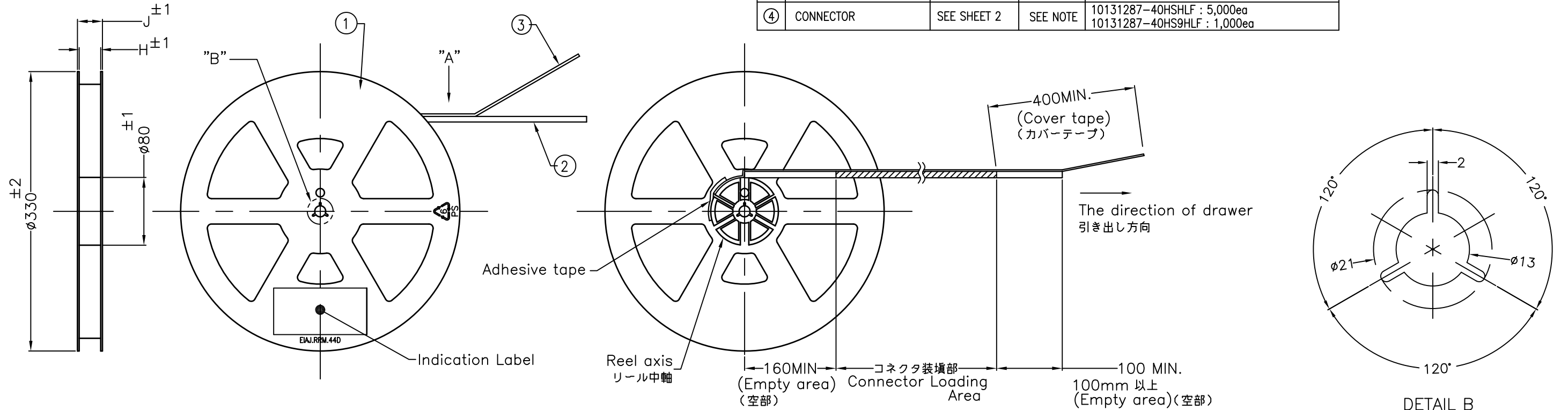


PRODUCT NO.	E	F	G	H	J	No. of Contact	Status
10131287-40HSHLF	14.2	28.4	32	33.5	37.5	40 pos	AVAILABLE
10131287-40HS9HLF	14.2	28.4	32	33.5	37.5	40 pos	AVAILABLE

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	NOTE
①	THE REEL FOR PACKAGING	POLYSTYRENE	1	Color : WHITE ELECTRIFICATION PREVENTION PROCESSING
②	EMBOSS TAPE	PP or PET	1	ELECTRIFICATION PREVENTION PROCESSING
③	COVER TAPE	POLYESTER	1	
④	CONNECTOR	SEE SHEET 2	SEE NOTE	10131287-40HSHLF : 5,000ea 10131287-40HS9HLF : 1,000ea

EMBOSS PACKAGE



NOTE

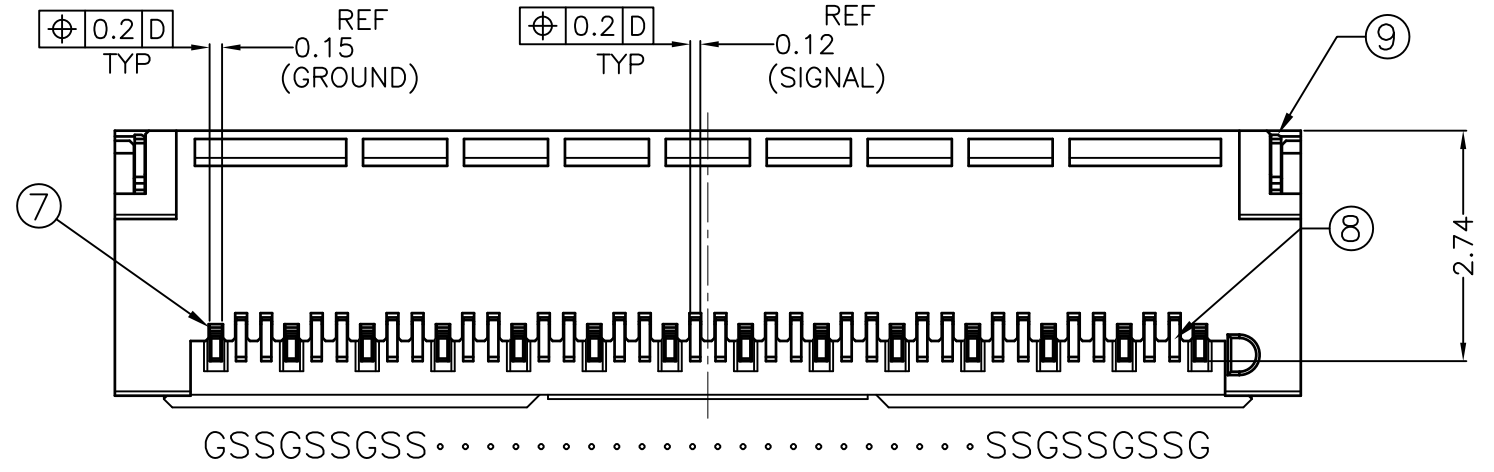
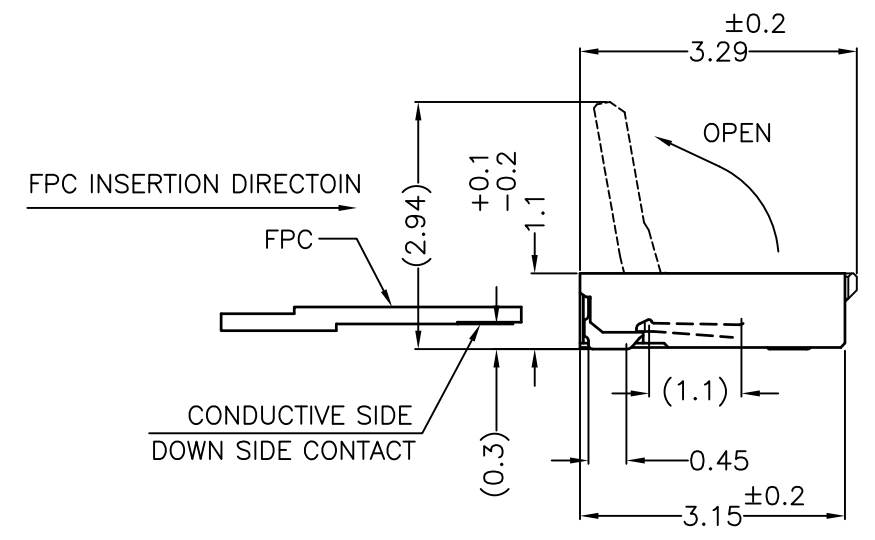
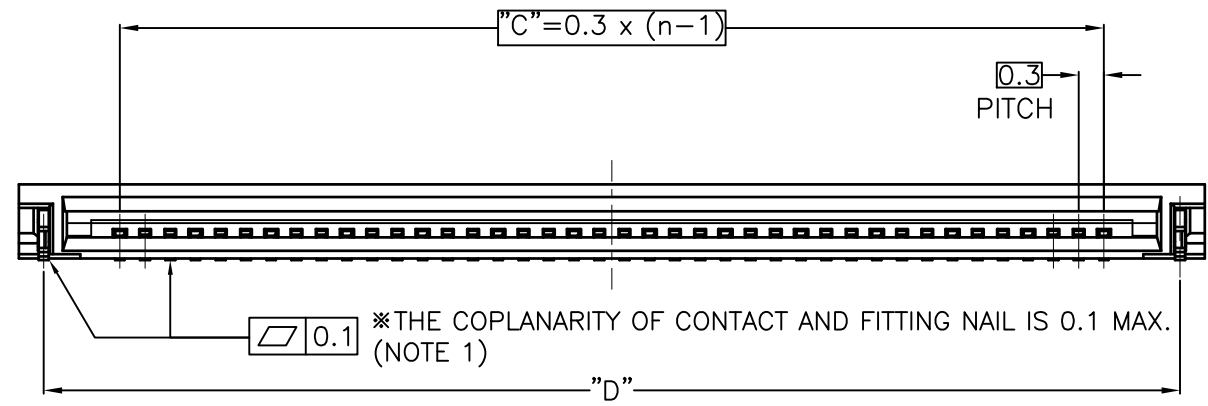
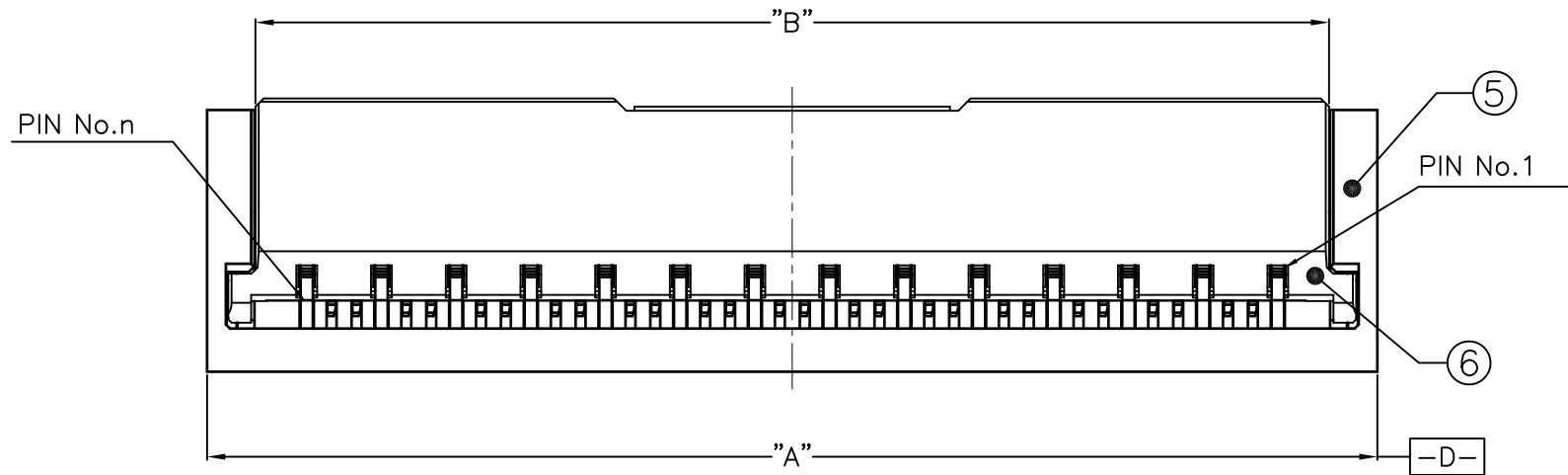
1. THIS ARTICLE CARRIES OUT THE EMBOSS TAPE PACKAGE OF THE CONNECTOR FOR 0.3mm PITCH HS FPC CONNECTOR.
2. THE SHAPE AND DIMENSION OF THIS ARTICLE ARE BASED ON JIS C 0806. (TAPING OF ELECTRIC PARTS< SURFACE MOUNTED DEVICE)
3. PACKAGING SPEC. : REFER TO GS-14-2478
4. PRODUCT SPEC. : REFER TO GS-12-1301

mat'l. code		surface		tolerance		projection		product family	
---		ISO 1302		ISO 406		ISO 1101		58WF	
ltr		ecn no		dr		date		title	
A		N.S		2015-09-14				0.3mm PITCH HS FPC CONNECTOR ASSY	
B		ELX-J-23864		N.S		2016-03-30		(XXXXX SERIES)	
C		ELX-J-26134		N.S		2017-02-21		scale 10:1	
sheet		revision		C		C		dwg no	
index		sheet		1		2		10131287	
				3		4		sheet 1 of 4	
								size	
								A2	
								type	
								PRODUCT CUSTOMER Drawing	
								Rev.	
								C	

Amphenol FCI

© 2016 AFCI

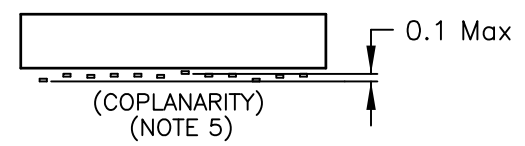
CONNECTOR ASSY



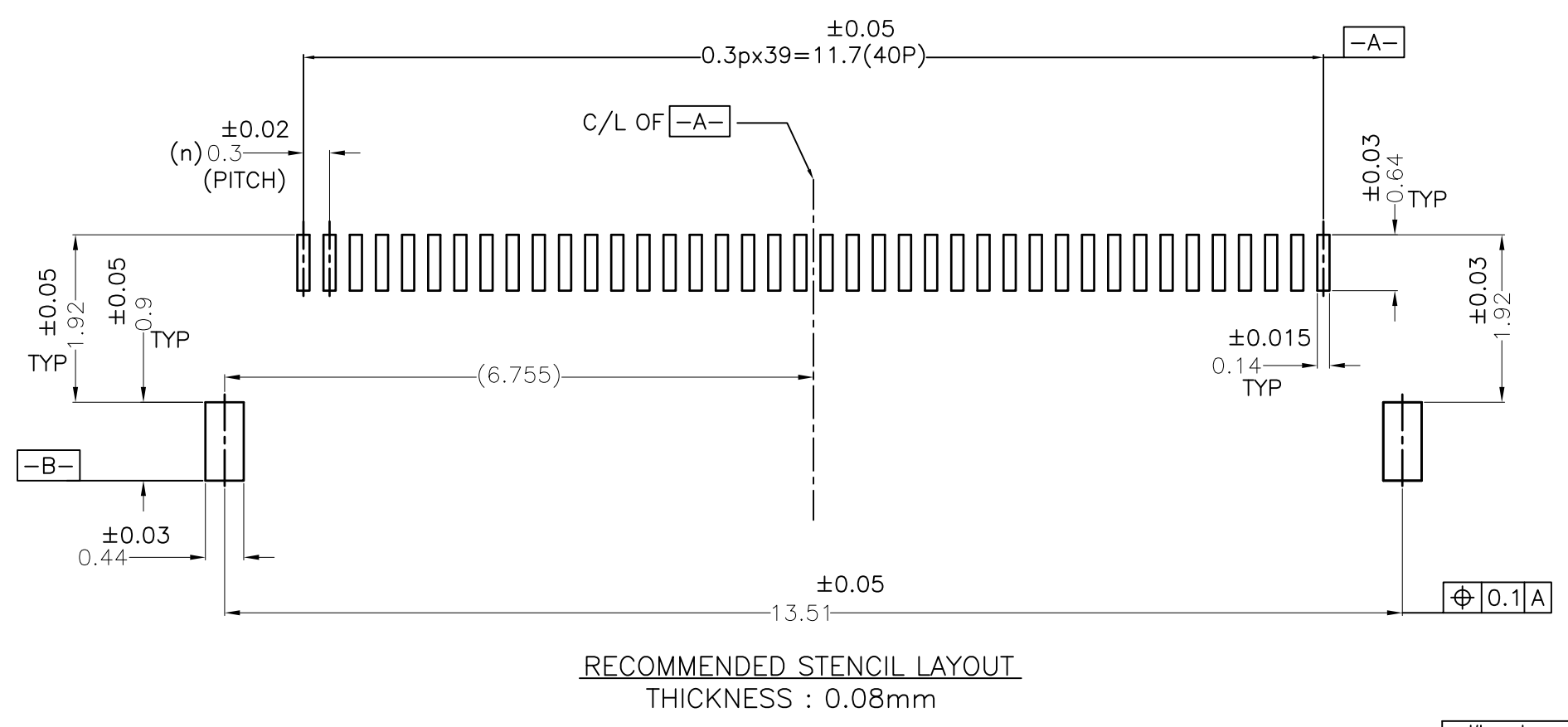
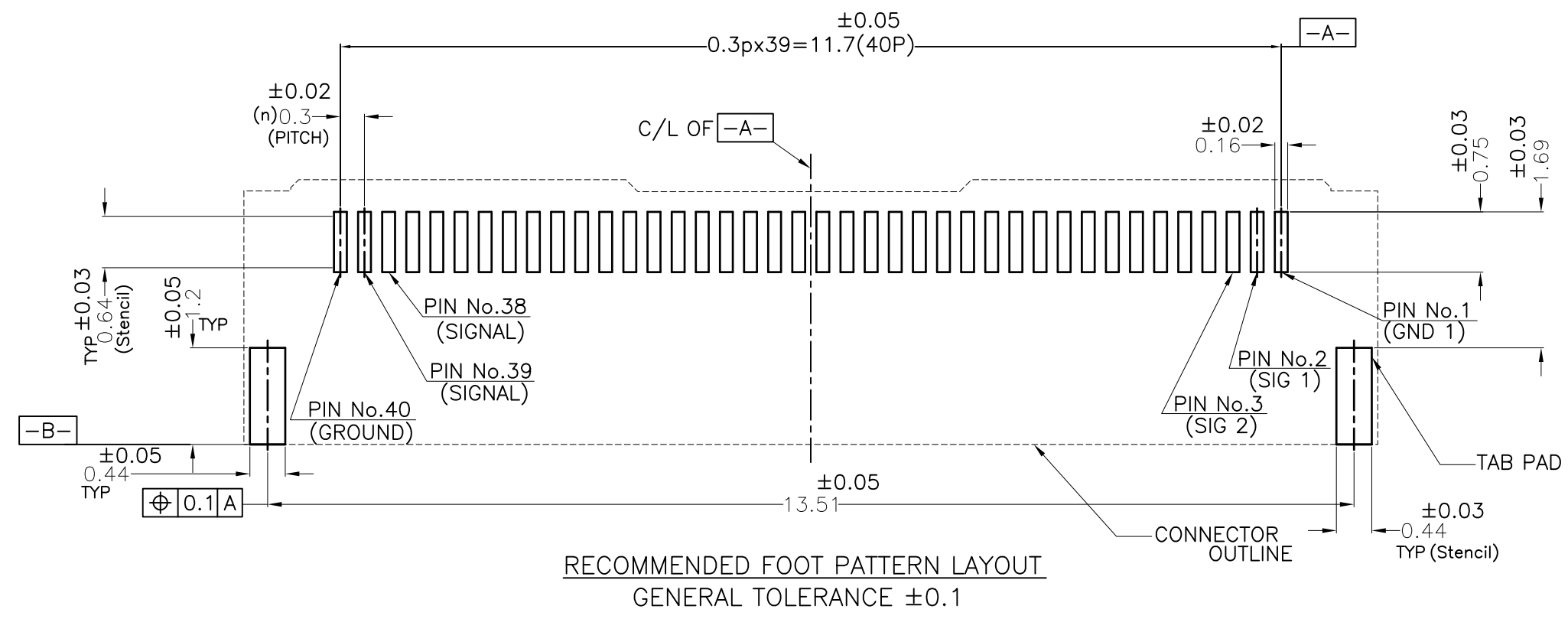
PARTS TABLE (CONNECTOR)			n=Number of Contacts
No.	PART NAME	QTY.	NOTE
⑤	HOUSING	1	HIGH TEMP THERMOPLASTIC LCP XXXXXXXXXX COLOR : BLACK , UL94V-0, HALOGEN FREE
⑥	ACTUATOR	1	HIGH TEMP THERMOPLASTIC PPS XXXXXXXXXX COLOR : BLACK , UL94V-0, HALOGEN FREE
⑦	GROUND CONTACT	14	COPPER ALLOY (CORSON ALLOY) CONTACT AREA : Au 0.05um MIN SOLDERING AREA : Au 0.05um MIN UNDER PLATING : Ni 3±2um ALL OVER
⑧	SIGNAL CONTACT	26	COPPER ALLOY (PHOSPHOR BRONZE) CONTACT AREA : Au 0.05um MIN SOLDERING AREA : Au 0.05um MIN UNDER PLATING : Ni 3±2um ALL OVER
⑨	FIXING TAB	2	COPPER ALLOY (PHOSPHOR BRONZE) TIN PLATING 2~5um UNDER PLATING : Ni 3±2um ALL OVER

NOTE

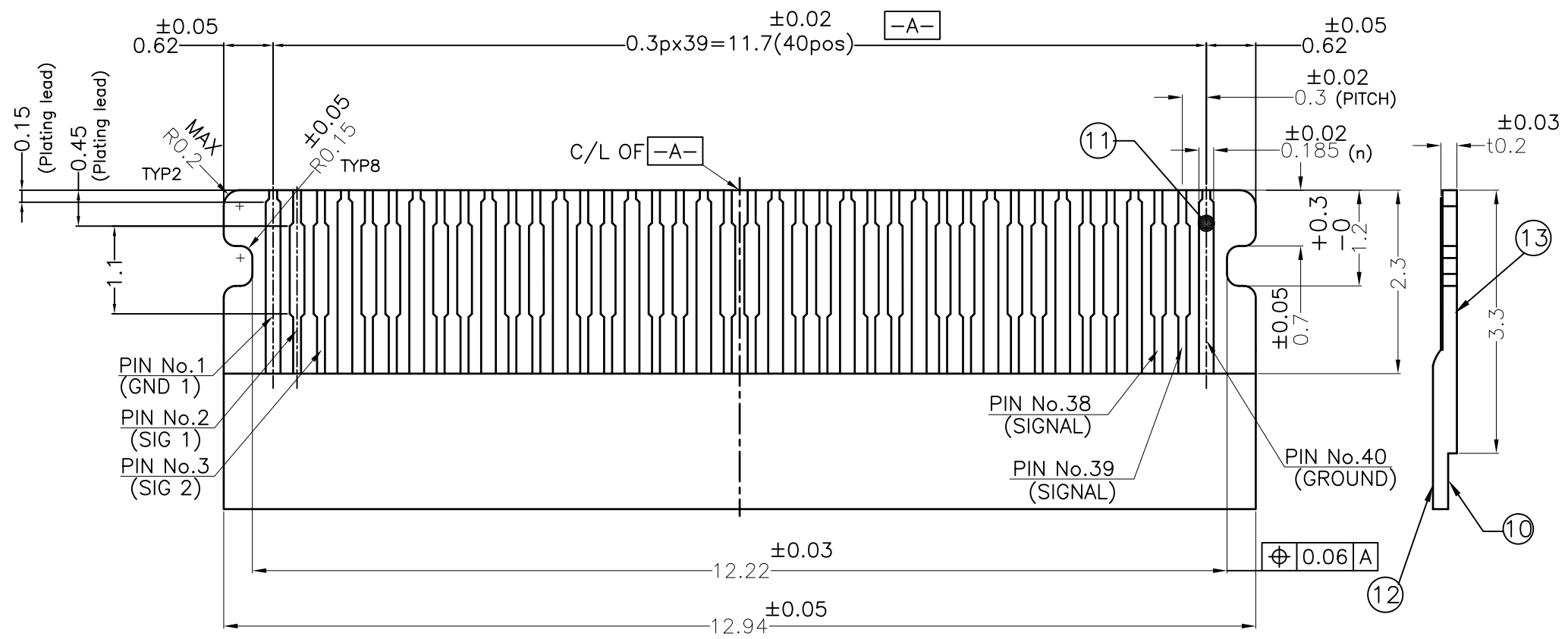
- CONTACT COPLANARITY : 0.1 MAX.
- This product meets European Union Directives and other country regulations as described in GS-47-0004
- THIS HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260DegC PEAK TEMPERATURE FOR 10 SECONDS IN A CONVECTION, INFRA-RED OR VAPOR PHASE REFLOW OVEN.



AVAILABLE	40	13.51	11.7	12.935	14.1	10131287-40HSAHLF
TOOLING STATUS	No.of Cont	DIM "D"	DIM "C"	DIM "B"	DIM "A"	PRODUCT NO.
mat'l. code	surface	tolerance	projection	product family		
---	ISO 1302	ISO 406 ISO 1101	mm	58WF		
lfr	ecn no	dr	date	title		
A	N.S	2015-09-14	angles	0.3mm PITCH HSFFPC CONNECTOR ASSY		
B	ELX-J-23664	N.S	2016-03-30	(XXXXX SERIES)		
C	ELX-J-26134	N.S	2017-02-21	scale 10:1		
	dr	N.SASAME	2017-02-21	dwg no		
	enrg	N.SASAME	2017-02-21	sheet 2 of 4		
	chr	H.SUZUKI	2017-02-21	size		
	appd	Y.KAMEDA	2017-02-21	A2		
sheet	revision			type		
index	sheet			PRODUCT CUSTOMER Drawing		
				Rev. C		



mat'l. code		surface		tolerance		projection		product family	
---		ISO 1302 ✓		ISO 406 ISO 1101		mm		58WF	
ltr		ecn no		dr		date		title	
A		N.S		2015-09-14		tolerances unless otherwise specified		0.3mm PITCH HSFPD CONNECTOR ASSY	
B		ELX-J-23664		N.S		2016-03-30		(XXXXX SERIES)	
C		ELX-J-26134		N.S		2017-02-21		scale 10:1	
		dr		N.SASAME		2017-02-21		dwg no	
		enr		N.SASAME		2017-02-21		sheet 3 of 4	
		chr		H.SUZUKI		2017-02-21		size	
		appd		Y.KAMEDA		2017-02-21		A2	
sheet		revision						type	
index		sheet						PRODUCT CUSTOMER Drawing	
								Rev. C	



RECOMMENDED FPC PATTERN LAYOUT
GENERAL TOLERANCE ±0.1

PARTS TABLE (FPC)

No.	PART NAME	MATERIAL
⑩	BASE FILM	POLYIMIDE
⑪	CONDUCTOR	COPPER FOIL (PLATING : Au 0.1um)
⑫	OVER LAY	POLYIMIDE
⑬	STIFFENER BOARD	POLYIMIDE

NOTE
8. ADHESIVE METHOD OF STIFFENER BOARD SHALL BE HEAT CRIMPING METHOD AND THERMOSETTING ADHESIVE SHALL BE USED.

mat'l. code		surface		tolerance		projection		product family	
---		ISO 1302 ✓		ISO 406 ISO 1101		⊕		58WF	
ltr		ecn no		dr		date		title	
A		N.S		2015-09-14		angles		0.3mm PITCH HSFPC CONNECTOR ASSY	
B		ELX-J-23664		N.S		2016-03-30		(XXXXX SERIES)	
C		ELX-J-26134		N.S		2017-02-21		scale 10:1	
		dr		N.SASAME		2017-02-21		dwg no	
		enfr		N.SASAME		2017-02-21		sheet 4 of 4	
		chr		H.SUZUKI		2017-02-21		size	
		appd		Y.KAMEDA		2017-02-21		A2	
sheet		revision						type	
index		sheet						PRODUCT CUSTOMER Drawing	
								Rev. C	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.